(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202969836 U
(45)授权公告日 2013.06.05

(21)申请号 201220634573.6

(22)申请日 2012.11.27

(73)专利权人 李莉
地址 610000 四川省成都市锦江区海椒市街6号2栋2单元4楼1-1号

(72)发明人 李莉

(74)专利代理机构 成都天嘉专利事务所（普通合伙） 51211
代理人 毛光军

(51)Int.Cl.
E04F 15/02(2006.01)
B32B 13/10(2006.01)

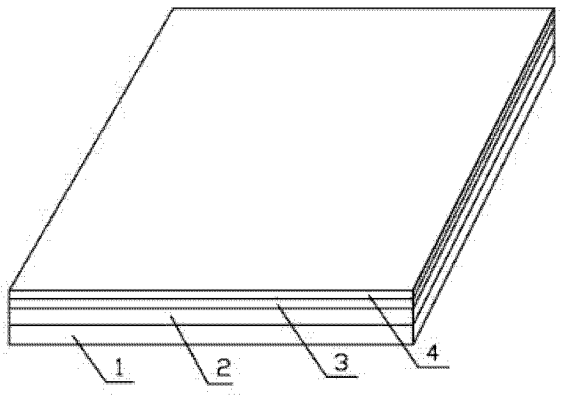
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

耐磨防水木地砖

(57)摘要

本实用新型公开了一种耐磨防水木地砖，包括位于底层的陶瓷基体和粘接在陶瓷基体上的木面板，其特征在于：所述木面板表面上粘接有防水层，所述防水层上粘接有耐磨层。本实用新型在木面板表面复合防水层，能够有效防水，延长地砖使用寿命，在防水层上复合耐磨层，大大提高木地砖本身的耐磨性。



CN 202969836 U

1. 耐磨防水木地砖，包括位于底层的陶瓷基体（1）和粘接在陶瓷基体（1）上的木面板（2），其特征在于：所述木面板（2）表面上粘接有防水层（3），所述防水层（3）上粘接有耐磨层（4）。

2. 根据权利要求 1 所述耐磨防水木地砖，其特征在于：所述防水层（3）的厚度为 0.5-1.5 毫米。

3. 根据权利要求 1 所述耐磨防水木地砖，其特征在于：所述耐磨层（4）的厚度为 0.5-1.5 毫米。

4. 根据权利要求 1 或 3 所述耐磨防水木地砖，其特征在于：所述耐磨层（4）为三氧化二铝，耐磨转数为 3500 转。

耐磨防水木地砖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种地砖，尤其是一种不易磨花、耐磨性强且防水效果好的耐磨防水木地砖。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高，人们对生活品质的要求也越来越高，其中尤以家居装饰最为突出。市面上的地面装饰材料多种多样，而地砖往往是消费者装饰家居的首选。地砖作为一种大面积铺设的地面材料，用黏土烧制而成，多用于公共建筑和民用建筑的地面和楼面。地砖靠其自身的颜色、质地营造出风格迥异的居室环境。现在市场上砖的种类很齐全，地砖花色品种非常多，可供选择的余地很大，按材质可分为釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖等。人们选择时，可以根据自己的预算和喜好选择品牌，根据居室的风格设计选择相应风格的地砖。色彩明快的玻化砖装饰现代的家居生活，沉稳古朴的釉面砖放在中式、欧式风格的房间里相得益彰，而创意新颖、气质不俗的花砖又起到画龙点睛的作用。

[0003] 地砖的铺设方法通常为湿铺法和干铺法两种。其中湿铺法是很多家装业主普遍采用的地砖铺贴方法，这种方法工艺与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆。采用湿铺法的地砖地面有可能产生空鼓与气泡，影响地砖的使用寿命，但是由于湿铺法操作简易，且价格较低，所以现在很多家庭采用湿铺法铺贴地面。而按理论上来讲，地砖应该采用干铺法。把基层浇水湿润后，除去浮沙、杂物。抹结合层，使用一比三的干性水泥沙浆，按照水平线探铺平整，把砖放在沙浆上用胶皮锤振实，取下地砖浇抹水泥浆，再把地砖放实振平即可。采用干铺法能够有效地避免地砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生，但是由于地砖干铺法比较费工，技术含量较高，所以一般干铺法要比湿铺法的费用高很多。不管是采用哪种方式铺设地砖，对地砖本身品质的要求都较高。只有本身品质高的地砖铺设出来的地面才经久耐用且亮丽美观。公开号为CN 201614714U，公开日为2010.10.27的中国专利文献公开了一种复合木地砖，包括有平板陶瓷基体、木面板，其特征在于：木面板敷覆于陶瓷基体的平滑表面上，木面板与陶瓷基体之间由粘合剂粘连一体，木面板的周边与陶瓷基体周边对应齐平。这样的构造，用陶瓷作为底基，由于陶瓷的硬度较高，所以与地面接触，不易损坏，而且能够起到很好的防潮作用，延长使用寿命。表面采用木面板，木面板虽然纹路清晰，用在家具里给人感觉很温馨。但是，木面板不耐磨，时间久了不但易褪色，而且易磨花。木面板一旦磨花，不但影响美观，而且影响整个地砖的使用寿命，此外防水效果差，也会影响地砖的使用寿命。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在针对上述现有技术木面板易褪色、易磨花和防水效果差的缺陷，提供一种不易褪色、不易磨花且防水效果好的耐磨防水木地砖。本实用新型在木面板表面复合防水层，能够有效防水，延长地砖使用寿命，在防水层上复合耐磨层，大大提高木地砖本身的耐磨性。

[0005] 为了实现上述发明目的，本实用新型采用的技术方案为：

[0006] 耐磨防水木地砖，包括位于底层的陶瓷基体和粘接在陶瓷基体上的木面板，其特征在于：所述木面板表面上粘接有防水层，所述防水层上粘接有耐磨层。

[0007] 所述防水层的厚度为 0.5-1.5 毫米。

[0008] 所述耐磨层的厚度为 0.5-1.5 毫米。

[0009] 所述耐磨层为三氧化二铝，耐磨转数为 3500 转。

[0010] 本实用新型的有益效果主要表现在以下三个方面：

[0011] 一、本实用新型，与公开号为 CN 201614714U，公开日为 2010.10.27 的中国专利文献相比，在木面板表面上粘接有防水层，能够有效防水，延长地砖使用寿命；在防水层上粘接有耐磨层，大大提高木地砖本身的耐磨性。

[0012] 二、本实用新型，与公开号为 CN 201614714U，公开日为 2010.10.27 的中国专利文献相比，防水层的厚度为 0.5-1.5 毫米，保证防水效果的同时，能够减轻地砖重量。

[0013] 三、本实用新型，与公开号为 CN 201614714U，公开日为 2010.10.27 的中国专利文献相比，耐磨层的厚度为 0.5-1.5 毫米，且耐磨转数为 3000-3500 转，大大提高了地砖耐磨性。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型的结构示意图

[0015] 图中标记：1、陶瓷基体，2、木面板，3、防水层，4、耐磨层。

具体实施方式

[0016] 实施例 1

[0017] 耐磨防水木地砖，包括位于底层的陶瓷基体 1 和粘接在陶瓷基体 1 上的木面板 2，所述木面板 2 表面上粘接有防水层 3，所述防水层 3 上粘接有耐磨层 4。所述防水层 3 的厚度为 0.5 毫米。所述耐磨层 4 的厚度为 0.5 毫米。

[0018] 实施例 2

[0019] 耐磨防水木地砖，包括位于底层的陶瓷基体 1 和粘接在陶瓷基体 1 上的木面板 2，所述木面板 2 表面上粘接有防水层 3，所述防水层 3 上粘接有耐磨层 4。所述防水层 3 的厚度为 1 毫米。所述耐磨层 4 的厚度为 1 毫米。

[0020] 实施例 3

[0021] 耐磨防水木地砖，包括位于底层的陶瓷基体 1 和粘接在陶瓷基体 1 上的木面板 2，所述木面板 2 表面上粘接有防水层 3，所述防水层 3 上粘接有耐磨层 4。

[0022] 所述防水层 3 的厚度为 1.5 毫米。

[0023] 所述耐磨层 4 的厚度为 1.5 毫米。

[0024] 所述耐磨层 4 为三氧化二铝，耐磨转数为 3500 转。

[0025] 本实用新型的实施方式不限于以上实施例，但均应落入本实用新型权利要求保护范围之内。

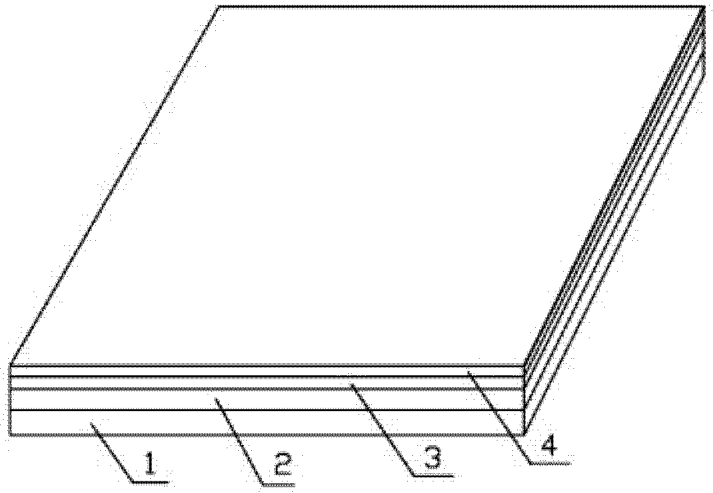


图 1